

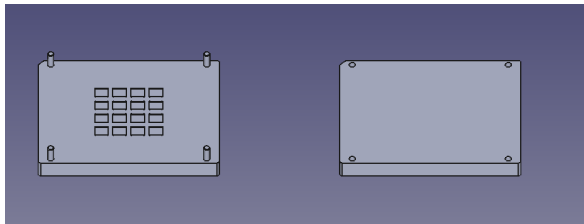


燒結壓合石墨治具_採購規範書

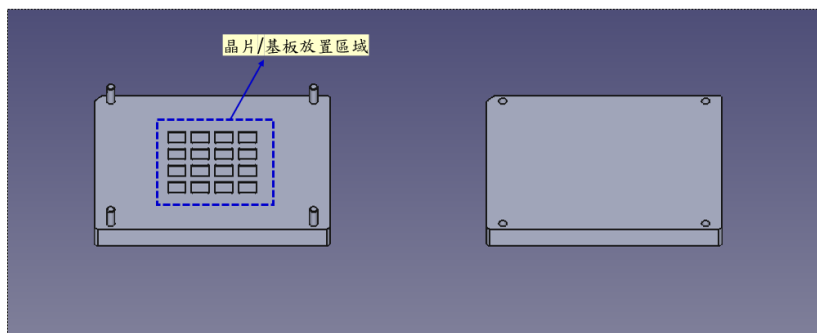
品名：燒結壓合石墨治具

案號: A512004123

- ◇ 目的/用途說明：用於晶片燒結製程之晶片固定、定位及壓合作業。
- ◇ 規格/功能需求：依附件圖檔「Embedded_sinter_20260821」所示之尺寸及規格製作。



- ◇ 安裝/測試要求：無特別要求
- ◇ 檢測/驗收標準：
 - 1.依圖檔尺寸檢驗：晶片／基板放置區域 ± 0.1 mm，其餘區域 ± 0.2 mm。
 - 2.上、下模手動合模／分離順暢，無卡滯或卡死。



- ◇ 交貨期：115 年 10 月 2 日前
- ◇ 訓練：無特別要求
- ◇ 保固：無特別要求
- ◇ 廠商交付文件：無特別要求
- ◇ 工作環境及安全衛生注意事項：無特別要求
- ◇ 其他：無特別要求
- ◇ 廠商資格條件：無特別要求

撰寫人： 柯秀奎 日 期： 115/8/31